

GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse
Version 1.0 (not for new design)

SFH 426



Features:

- **Replacement:** SFH 4256
- Very highly efficient GaAlAs-LED
- High reliability
- High pulse handling capability
- Suitable for surface mounting (SMT)
- Available on tape and reelAvailable on tape and reel
- SFH 426 same package as SFH 325
- Good linearity at high currents

Besondere Merkmale:

- **Ersatz:** SFH 4256
- GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Oberflächenmontage geeignet
- Gegurtet lieferbar
- SFH 426 Gehäusegleich mit SFH 325
- Gute Linerarität bei hohen Strömen

Applications

- Miniature photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Automotive technology
- Sensor technology
- Alarm and safety equipment
- IR free air transmission

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“
- Automobiltechnik
- Sensorik
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR-Freiraumübertragung

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_e [\text{mW/sr}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 426	7 (≥ 4)	Q65110A2512

Note: Measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	100	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 10 \mu\text{s}, D = 0$)	I_{FSM}	2.5	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	180	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 13} Wärmewiderstand Sperrsicht - Umgebung 1) Seite 13	R_{thJA}	450	K / W
Thermal resistance junction - soldering point 2) page 13 Wärmewiderstand Sperrsicht - Lötstelle ^{2) Seite 13}	R_{thJS}	200	K / W

Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	λ_{peak}	880	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	$\Delta\lambda$	80	nm
Half angle Halbwinkel	Φ	± 60	°
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.09	mm^2
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.3 x 0.3	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e\text{ max}}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e\text{ max}}$) ($I_F = 100 \text{ mA}$, $R_L = 50 \Omega$)	t_r, t_f	500	ns
Capacitance Kapazität ($V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$)	C_0	15	pF
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	V_F	1.5 (≤ 1.8)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 1 \text{ A}$, $t_p = 100 \mu\text{s}$)	V_F	3 (≤ 3.8)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5 \text{ V}$)	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	Φ_e	23	mW

Version 1.0 (not for new design)**SFH 426**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC _I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC _V	-2	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC _λ	0.25	nm / K

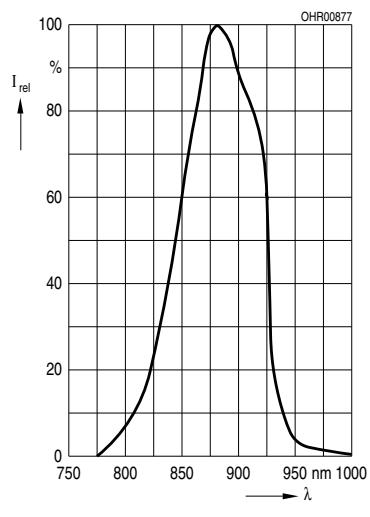
Grouping ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)**Gruppierung**

Group Gruppe	Min Radiant Intensity Min Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, min} [\text{mW / sr}]$	Typ Radiant Intensity Typ Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, typ} [\text{mW / sr}]$	Typ Radiant Intensity Typ Strahlstärke $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$ $I_{e, typ} [\text{mW / sr}]$
SFH 426	4	7	48

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission

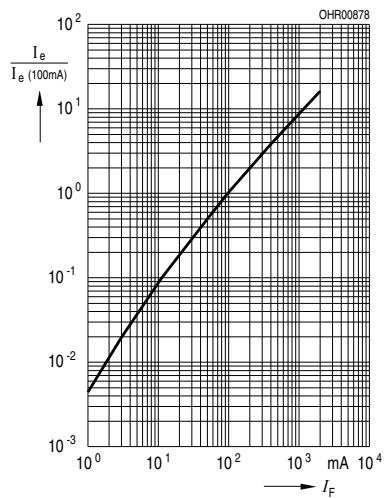
$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



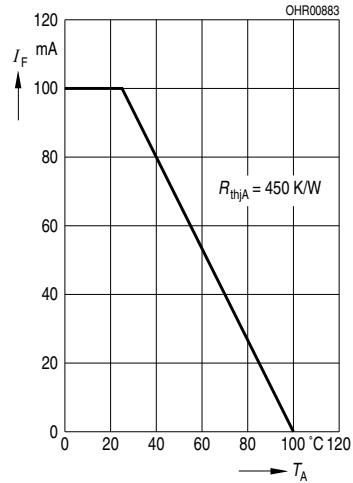
Radiant Intensity

Strahlstärke

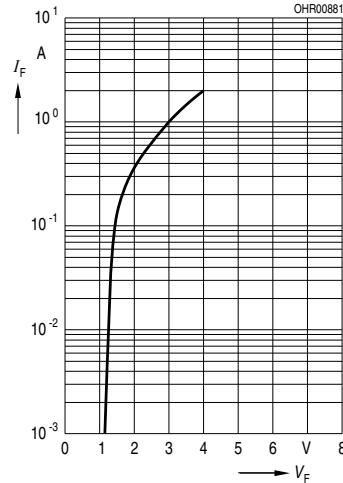
$I_e / I_e(100 \text{ mA}) = f(I_F)$, single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$,
 $T_A = 25^\circ\text{C}$



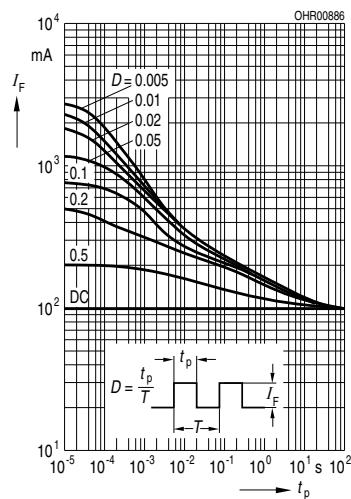
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
 $I_{F,\max} = f(T_A)$



Forward Current
Durchlassstrom
 $I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu\text{s}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

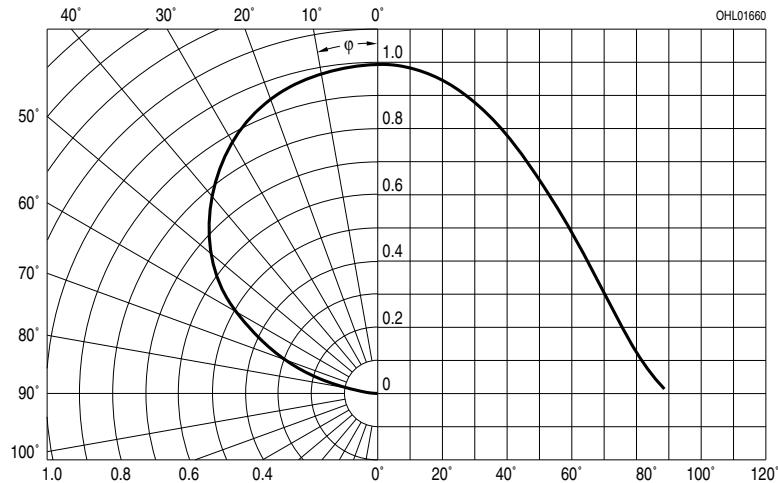
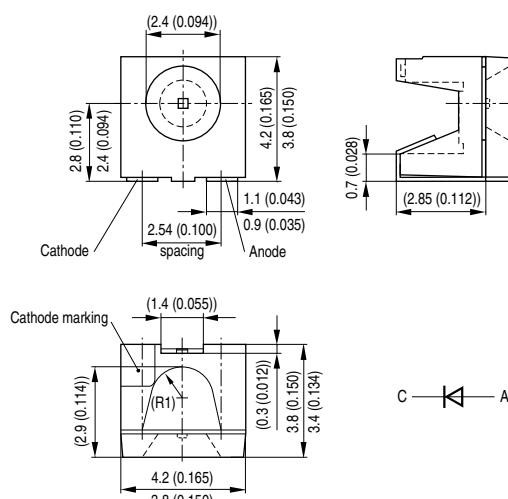


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
 $I_F = f(t_p)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, duty cycle D = parameter



Radiation Characteristics**Abstrahlcharakteristik**

$$I_{\text{rel}} = f(\phi)$$

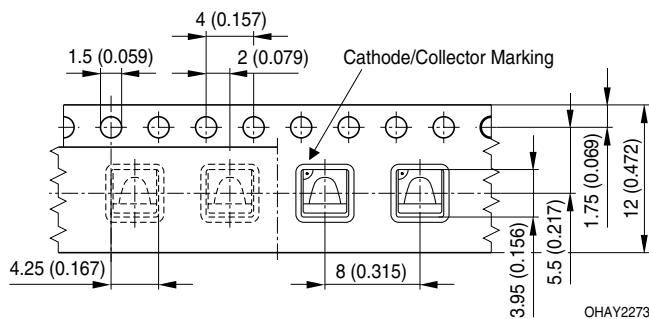
**Package Outline
Maßzeichnung**

Version 1.0 (not for new design)**SFH 426****Package**

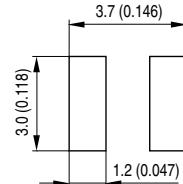
SIDELED, cathode marking: bevelled edge

Gehäuse

SIDELED, Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke

**Method of Taping
Gurtung***Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).*

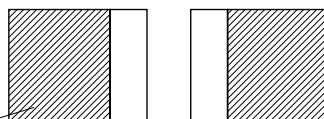
**Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign**



Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung

Paddesign
for improved
heat dissipation

Cu-Fläche > 16 mm²
Cu-area > 16 mm²



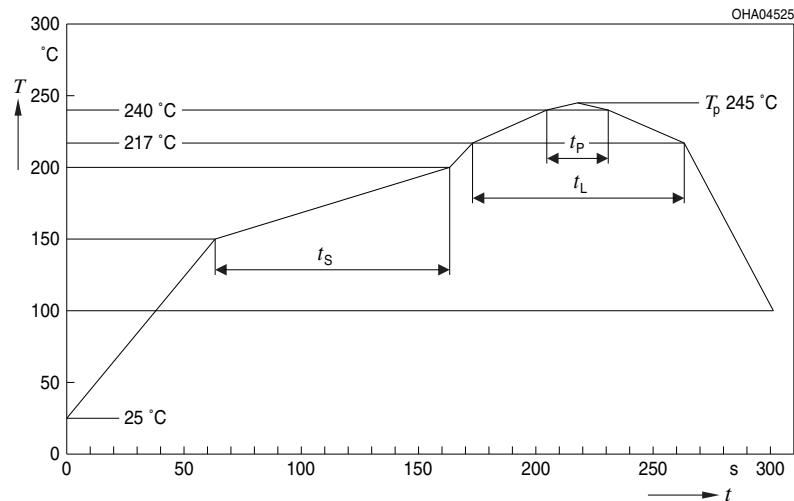
■ Löstopplack
Solder resist

OHLPY965

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



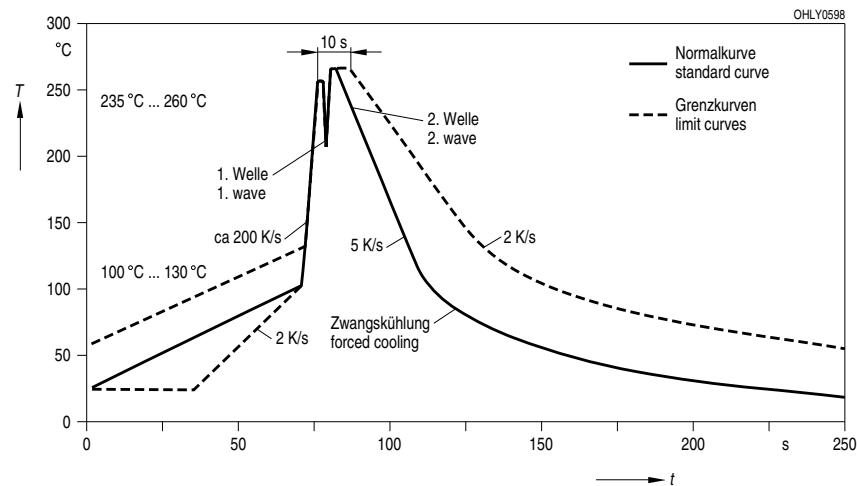
Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $150\text{ }^{\circ}\text{C}$			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L	217			°C
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_p		245	250	°C
Time within $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ of the specified peak temperature $T_p - 5\text{ K}$	t_p	10	20	30	s
Ramp-down Rate* T_p to $100\text{ }^{\circ}\text{C}$			3	4	K/s
Time $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

TTW Soldering**Wellenlöten (TTW)**

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm² each
- 2) **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperrsicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm²
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperrsicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；

国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for osram manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LS E65B-V1AB-1-1-50-R33-Z](#) [LO L296-Q2S1-24-Z](#) [IPD2131-27](#) [2351MFX6](#) [2352MFX6](#) [GW PSLPS1.EC-KSKU-5R8T-1](#) [418962A](#) [LCW JNSH.PC-CPCR-5H7I-1](#) [LE RTDUW S2W](#) [LT A67C-S2U1-35](#) [4052899958142](#) [4052899958173](#) [4052899971028](#) [4052899971035](#) [4052899971042](#) [BPW 34 FASR](#) [BPW 34 FSR](#) [BPW 34 SR](#) [LT A67C-T2V1-35](#) [GY CSHPM1.23-KQKS-36-0](#) [4052899971011](#) [KW H5L531.TE-Z7R7-EBVFFCBB46-RS5R](#) [4058075097421](#) [79675](#) [79632](#) [OT 40/220-240/24 DIM P](#) [OT 60/220-240/24 DIM P](#) [OT 100/220-240/24 DIM P](#) [OT FIT 45/220-240/200 D L](#) [KW2 HIL532.TK-D2D9-4L07M0-SC6B](#) [LW TWTG.BB-BXCX-2B2C-1](#) [LA E6SF-BBCB-24-1-Z HDSP2112S](#) [LY E6SF-AABA-46-1-Z](#) [64760](#) [SFH 4715A-CBDA](#) [4058075097360](#) [4058075097544](#) [47659](#) [OT 6/200-240/24 CE](#) [OT FIT 35/220-240/350 D CS L](#) [OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI](#) [64150ULT](#) [79366](#) [4052899917583](#) [GW CSSRM2.PM-N3N5-XX51-1 ELEMENT 90/220-240/24](#) [OT 40/220-240/24 P](#) [OT 60/220-240/24 P](#) [ELEMENT 6/220-240/150 S](#)